

Nominal frequency (f0)

20 MHz

Frequency stabilities

Parameter	Frequency stability	Operating temp. range
Over all (df/f0)	-4.6 to 4.6 ppm	
vs. operating temp. range (df/f@25 °C)	-10 to 10 ppb	-40 ... 85 °C
Additional information Drift 24 Hr and $\pm 2.8^{\circ}\text{C}$ temp. change < ± 0.8 ppb over all include: Temp Stab, supply, load stab, inital, 20 years aging S3E compliant according GR1244		
Parameter	Value	Condition
initial tolerance (df/f0)	-500 to 500 ppb	@ 25 °C
vs. supply voltage change (df/f)	-10 to 10 ppb	static; 3.3 V ± 5 %
vs. load change (df/f)	-5 to 5 ppb	static; Load ± 5 %
vs. aging / daily (df/f)	< ± 1 ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / month (df/f)	< ± 25 ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / year (df/f)	< ± 100 ppb	after 30 days ; @ 25 °C
vs. aging / 10 years (df/f)	< ± 1 ppm	after 30 days ; @ 25 °C
Holdover 24 h	± 10 ppb	incl. Drift and -40..85°C temperature stability

RF output

Parameter	Value	Condition
Signal	LVC MOS	
Load	15 pF ± 10 %	
Fan out	3	
Rise Time	< 10 ns	@ 10 to 90 %Vout
Fall Time	< 10 ns	@ 90 to 10 %Vout
Duty cycle	45 / 55 %	@ 1.65 V
V Low	x < 0.4 V	
V High	x > 2.4 V	

Supply voltage

Parameter	Value	Condition
Supply voltage (Vs)	3.3 V ± 5 %	
Current consumption steady state	< 400 mA	@ Vsnom & 25 °C
Current consumption during warm up	< 950 mA	@ Vs

Additional Parameters

Parameter	Typ.	Max.	Condition
Phase Noise	-85	-60	dBc/Hz@1Hz
	-110	-90	dBc/Hz@10Hz
	-130	-115	dBc/Hz@100Hz
	-143	-130	dBc/Hz@1kHz
	-150	-145	dBc/Hz@10kHz
MTIE	0.2 ns		1 sec
	2.0 ns		10 sec
	7.0 ns		100 sec
	20.0 ns		1000 sec
	40.0 ns		10000 sec
Parameter	Value		Condition
Jitter	< 1.00 psec (RMS)		@ 12 kHz to 20 MHz
TDEV	0.01 ns		1 s
TDEV	0.1 ns		10 s
TDEV	1 ns		100 s
TDEV	3 ns		1000 s
Warm-up time	< 5 min		@ 25 °C to final frequency
Additional information TDEV: Typical Wander Generation performance when locked through a 1MHz system loop bandwidth Holdover 10ppb peak-peak: incl. of 24 h aging and a 40°C temperature change			
Processing & Packing	handling&processing note		

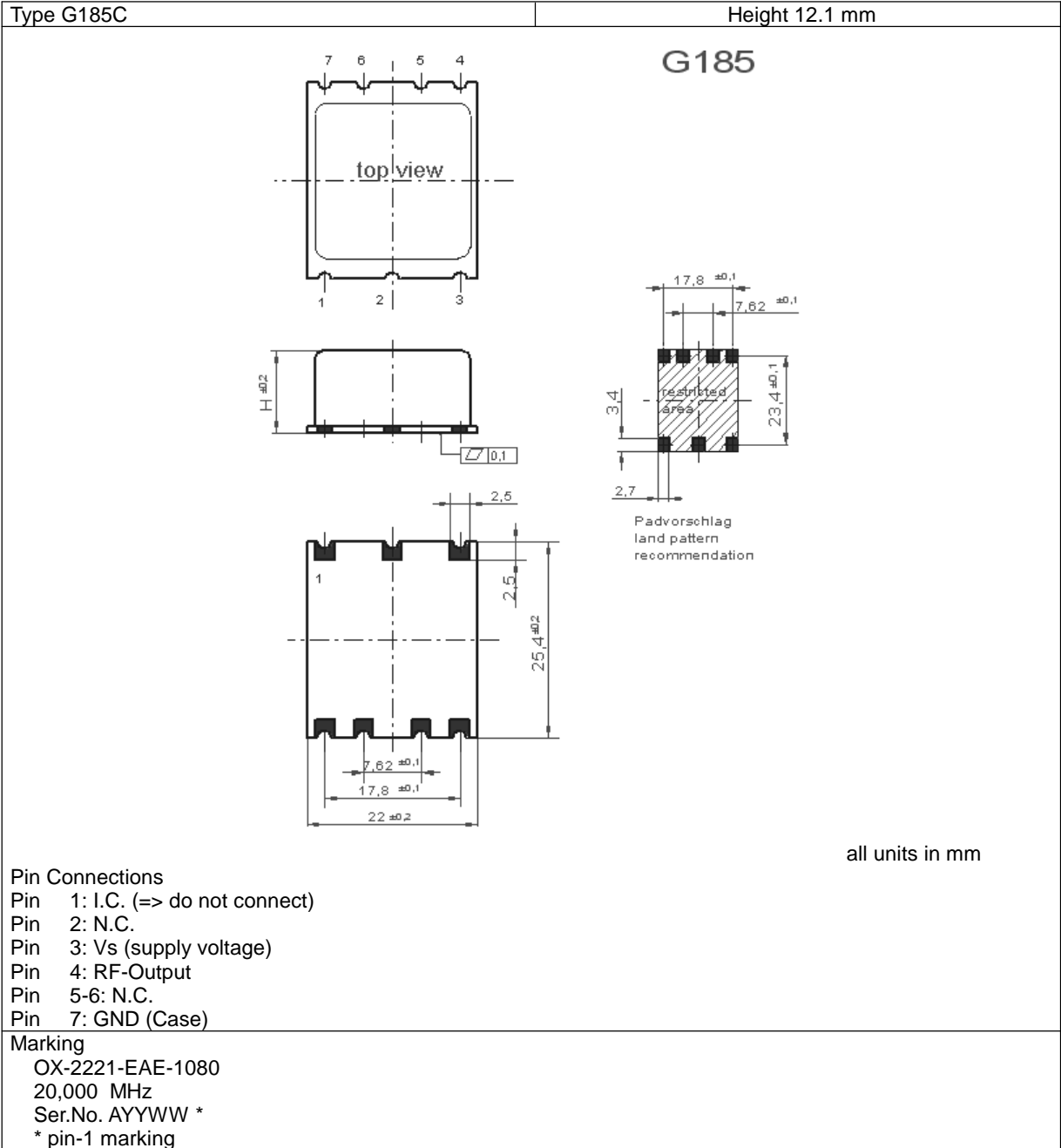
Additional environmental conditions

Sealing test A staubdicht (dust-dense)
Solderability DIN IEC 68-2-20 Test Ta 100% RoHS 6 compliant
Solvent resistance EN 60068-2-45, Test xA non-washable device

Absolute Maximum Ratings

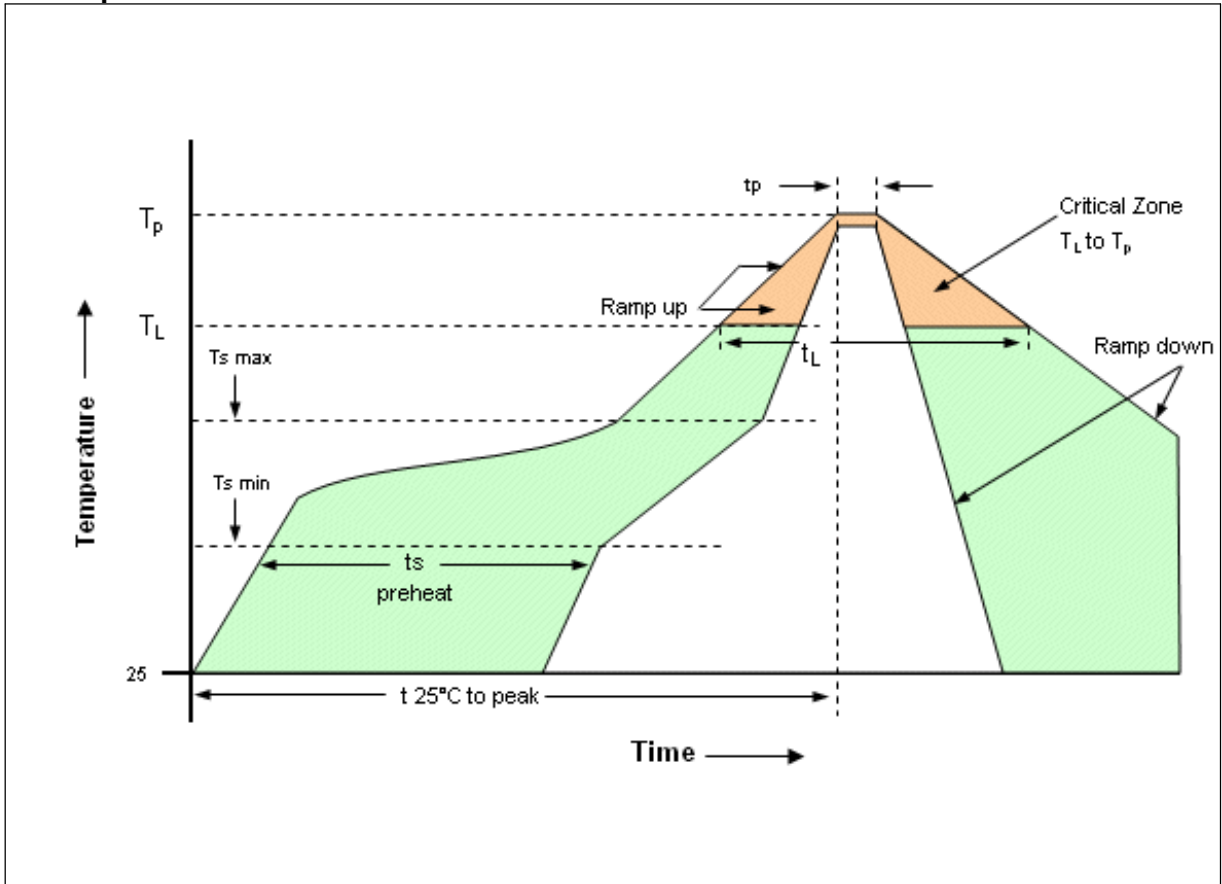
Parameter	Min	Typ	Max	Units	Condition
Operable temperature range	-40		85	°C	
Storage temperature range	-50		90	°C	

Enclosure



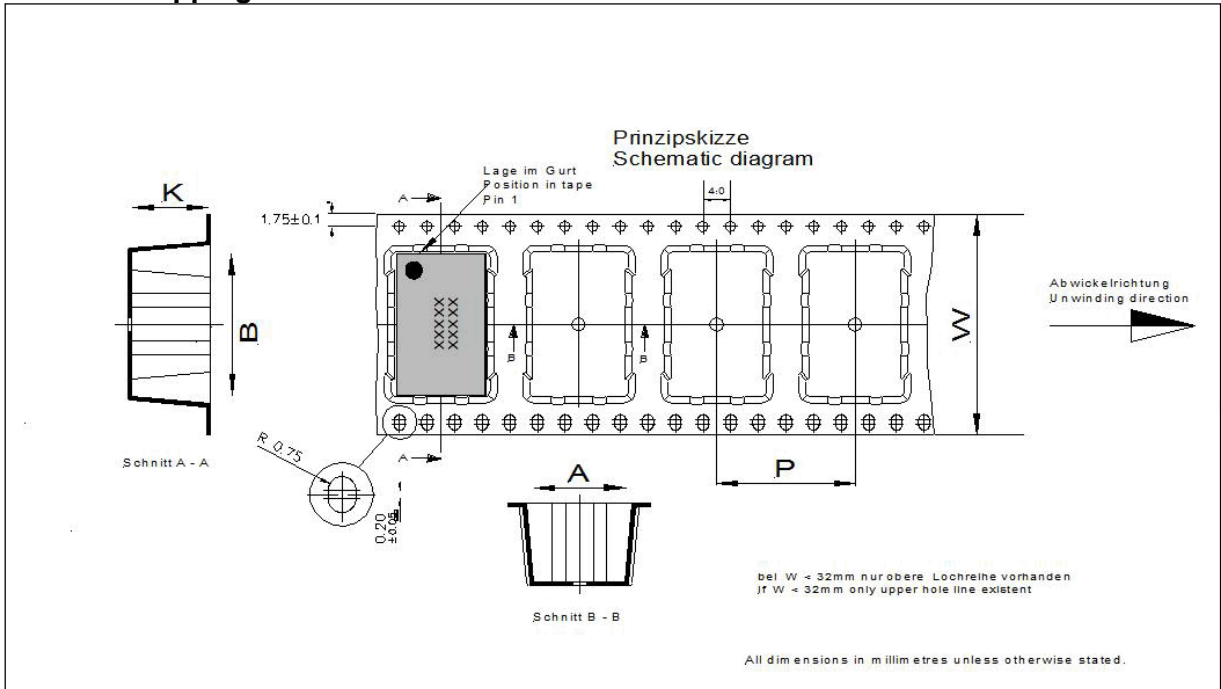
all units in mm

Reflow profile



Profile Feature	Pb-Free Assembly/Sn-Pb Assembly
Average ramp-up rate (TL to Tp)	3°C/second max.
Preheat -Temperature Min (T _{smin})	150°C
-Temperature Min (T _{smax})	200°C
-Time (min to max) (t _s)	60-180 seconds
T _{smax} to TL - Ramp-up Rate	3°C/second max.
Time maintained above - Temperature (TL)	217°C
- Time (t _L)	60-150 seconds
Peak Temperature (T _p)	max 260°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t _p)	20-40 seconds
Ramp-down Rate	6°C/second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.	
Additional Information	
This SMD oscillator has been designed for pick and place reflow soldering. SMD oscillators must be on the top side of the PCB during the reflow process.	

Standard shipping method



Tape width W [mm]	Quantity per meter	Quantity per reel	P [mm]	A [mm]	B [mm]	K [mm]
44	35.7	175	28	22.5	25.9	12.8

Notes:

Unless otherwise stated all values are valid after warm-up time and refer to typical conditions for supply voltage, frequency control voltage, load, temperature (25°C) .
Subject to technical modification.

For Additional Information, Please Contact

USA:
Vectron International
267 Lowell Road
Hudson, NH 03051
Tel: 1.888.328.7661
Fax: 1.888.329.8328

Europe:
Vectron International
Landstrasse, D-74924
Neckarbischofsheim, Germany
Tel: +49 (0) 7268.801.100
Fax: +49 (0) 7268.801.282

Asia:
Vectron International
1589 Century Avenue, the 19th Floor
Chantime International Financial Center
Shanghai, China
Tel: 86.21.6081.2888
Fax: 86.21.6163.3598

Disclaimer

Vectron International reserves the right to make changes to the product(s) and/or information contained herein without notice. No liability is assumed as a result of their use or application.
No rights under any patent accompany the sale of any such product(s) or information.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9